

合肥新汇成微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票166,970,656股，发行价为每股人民币8.88元，共计募集资金1,482,699,425.28元，坐扣承销和保荐费用131,269,942.53元（不含增值税）后的募集资金为1,351,429,482.75元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,069,835.33元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1,320,359,647.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕412号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，期末均无余额。募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行	1302045719100295856		已销户
华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001168508		已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100365322		已销户
招商银行股份有限公司合肥分行	514902669010558		已销户
	合计		

注：公司本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述全部募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1.前次募集资金投资项目变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的变更情况。

2.前次募集资金投资项目延期情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月
研发中心建设项目	2023 年 06 月	2023 年 09 月

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额存在差异，差异金额详见本报告附件 1，原因系闲置募集资金进行理财获得的收益以及募集资金存放产生的利息收入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1.截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2.公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 39,672.78 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于 2022 年 9 月 26 日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕9785 号）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”以公司为实施主体，计划达到预定可使用状态的时间为 2023 年 9 月。项目建成后将大幅提高公司研发的软硬件基础，进一步提升研发实力。本项目针对凸块结构优化、测试效率提升、倒装技术键合品质、CMOS 图像传感器封装工艺等加大研发投入，提升公司产品质量及生产效率，丰富公司产品结构，提升整体市场竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额为 0。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	132,035.96	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	100,961.92
	利息收入净额	B2	200.79
本期发生额	项目投入	C1	31,615.74
	利息收入净额	C2	340.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,577.65
	利息收入净额	D2=B2+C2	541.69
应结余募集资金	E=A-D1+D2		
实际结余募集资金	F		
差异	G=E-F		

注：本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：132,035.96						已累计使用募集资金总额：132,577.65				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2022 年：100,961.92 2023 年：31,615.74				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	97,406.15	78,000.00	78,493.88	97,406.15	78,000.00	78,493.88	493.88	2023 年 12 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,980.84	5,000.00	5,047.37	8,980.84	5,000.00	5,047.37	47.37	2023 年 9 月
3	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	49,035.96	49,036.40	50,000.00	49,035.96	49,036.40	0.44	
		合计	156,386.99	132,035.96	132,577.65	156,386.99	132,035.96	132,577.65	541.69	

注 1：“实际投资金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	截止日累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2022 年	2021 年		
1	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	不适用	11,496.93	7,516.82	5,034.09	不适用	12,550.91 [注 1]	是
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]

[注 1]12 吋显示驱动芯片封测扩能项目是以公司为实施主体，是公司利用现有厂区，在现有技术工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，公司 12 吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。由于该项目需与其他产线配套使用，公司未针对募投项目新增产能另设单独的管理、核算体系，故无法直接单独核算募投项目的经济效益。

为直观充分的披露募投项目情况，公司结合原有设备的产能情况和新增募投项目设备产能情况测算募投项目新增产量，再根据当期产品平均单价、平均单位成本、费用率等数据测算募投项目实现的效益（利润总额）。

[注 2]该项目无法单独核算效益。

[注 3]该项目无法单独核算效益。